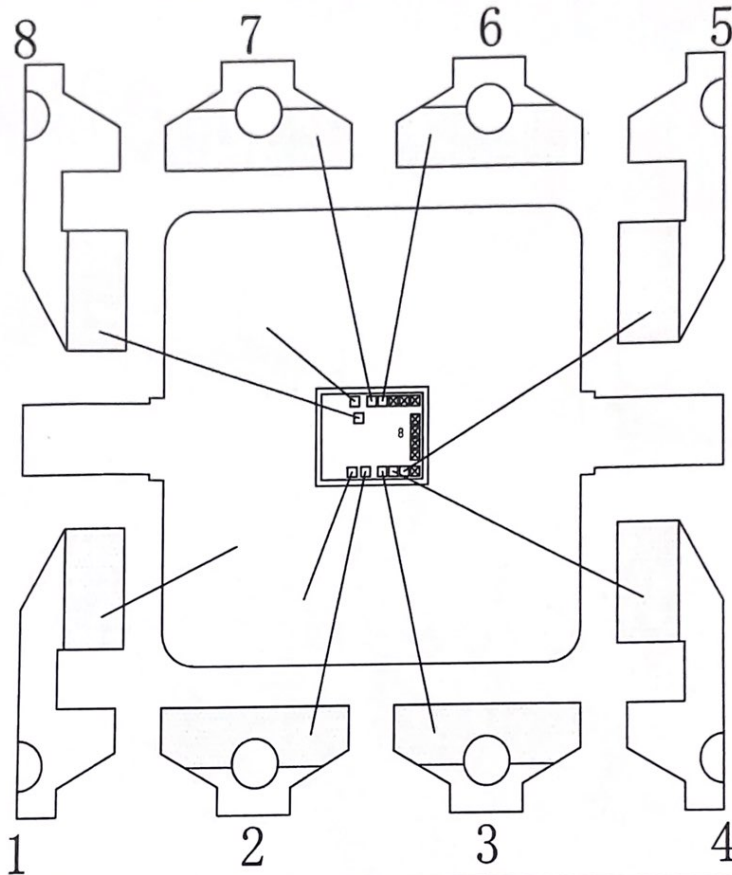
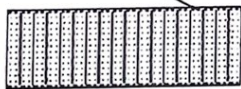
 池州华宇电子科技股份有限公司 CHIZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD 焊线图纸 Bonding Diagram				客户代码 Customer No.	008	线号 Drawing No.	HY-PX-008-735 A	
产品型号 Product Type				YL9000-I		封装外型 PKG Type	SOP8L (12R)	
焊线种类 Wire Type	焊线直径(μm) Wire Diameter	焊线根数 NO. of wire	焊线总长(μm) Total wire length	最长线长(μm) Longest wire length	最短线长(μm) Shortest wire length	塑料料号(绿色环保) Compound Type (Green)		LF载体尺寸 LF Pad Size
合金丝 Ag	20	10	14354	1550	616	优选(Preference): CEL-1702HF 备选(Options): EME-G630AV		SOP8L-12R (90°90mil) 2286*2286(μm ²)
客户图号 Customer drawing NO.								



载带传递方向(张片):
L/F Direction (D/A): 椭圆孔



引脚图:
Chip photo:

特殊说明 Special Instructions:

DB注意:
1.芯片居中放置;
2.控制引脚,为WB预留焊线位置;
WB注意:
1.数字为不打线pad个数;

注意:基岛全镀银

说明 Item	贴片胶类型 Epoxy type	芯片名称 Die name	芯片尺寸 Die Size	最小焊盘尺寸 Min BPP(μm ²)	最小焊盘间距 Min BPP(μm)	焊盘厚度(μm) Pad Thickness	焊盘下是否有电路 Circuit under Pad	划片进宽度 Street line (μm)	晶圆尺寸 Wafer Size	是否过 Length	减薄厚度 Spall Value/Thickness
A芯: DIE A	导电胶 (conductivity) 5210	H55122	554.8*433.2(μm ²) 21.84*17.06(mil ²)	50.35*50.35	59.85	1	是/Yes	60	8	否/NO	300
B芯: DIE B											
C芯: DIE C											

制图日期 Create Date	2024/2/22	生效日期 Effective Date		客户确认签字/盖章: Customer Signature	刘婷婷
编制 Prepared by	刘婷婷	审核 Checked by	刘婷婷	批准 Approved by	2024.02.23

温馨提示: 本图仅为产品生产之唯一依据, 请认真确认, 我司依据您签字后的图纸生产, 如因低档误读产生不可估量损失, 请慎重! Warm tips: the drawing is the only basis for the production of the product. Please confirm it carefully. Our company will produce the drawings according to the drawings you have signed back, such as drawing mistakes, which will produce inestimable loss. Thank you

页码 Page

1/1